第一图书网, tushu007.com

<<苏州香山帮建筑营造技艺>>

图书基本信息

书名：<<苏州香山帮建筑营造技艺>>

13位ISBN编号：9787533760465

10位ISBN编号：7533760468

出版时间：2013-8-1

出版时间：安徽科学技术出版社,时代出版传媒股份有限公司

作者：刘托,马全宝,冯晓东

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

<<苏州香山帮建筑营造技艺>>

内容概要

《苏州香山帮建筑营造技艺》是“中国传统建筑营造技艺”丛书之一。

“中国传统建筑营造技艺”丛书选自国家非物质文化遗产名录中最具价值、最能展现中国传统建筑文化的10个传统营造技艺项目。

“中国传统建筑营造技艺”丛书根据营造技艺的特点，分类型、分地区选取有代表性的传统建筑，介绍其历史、形制、结构、模数关系、加工方法、建造方式、工艺流程以及相关的文化习俗等内容。

“中国传统建筑营造技艺”丛书为传统建筑的保护和修缮提供了技术依据，对相关地区文化的形成给予建筑层面的诠释，深化了传统建筑营造技艺的研究，填补了传统建筑营造技艺领域的学术空白，对传统建筑营造技艺和非物质文化的传承起到巨大的促进作用。

作者简介

刘托“中国传统建筑营造技艺”丛书编委会主任。
清华大学建筑学硕士。
现任中国艺术研究院研究员、建筑艺术研究所所长、博士生导师。
《中国建筑艺术年鉴》副主编，非物质文化遗产国家级名录评审委员会委员，中国建筑学会建筑史学分会理事。
专著主要有《建筑艺术》、《园林艺术》、《濠镜风韵——澳门建筑》、《颐和园》、《澳门历史城区》、《皇陵建筑》等。
合著主要有《建筑美学》、《世界自然与文化遗产》。
主编的丛书主要有《中国古代园林风景图汇》、《中国世界遗产丛书》、《清殿版画汇刊》、《中国名山文化丛书》。
参与了《中国美术史》、《中华艺术通史》、《中国建筑史》等大型国家重点项目的撰写工作，发表了数十篇有关建筑文化、建筑艺术、建筑历史的专业论文。

马全宝，中国艺术研究院建筑研究所博士研究生，主要从事建筑历史与理论研究及文化遗产保护工作、建筑设计工作。
近年来主要从事的研究工作有：中国传统建筑营造技艺多媒体数据库建设工作；联合国人类非物质文化遗产“中国传统木结构建筑营造技艺”申报工作。
苏州香山帮传统营造技艺保护规划编写工作；非物质文化遗产数字化保护工程中“徽派传统民居”项目等。
发表的论文有《殊途回归—柯布西耶与密斯建筑设计作品中自由精神的表达》、《香山帮传统营造技艺田野考察与保护方法探析》、《精巧构筑未来——2010上海世博会展馆建筑》等，合著中国传统营造技艺丛书中苏州、闽南分册。
完成文物保护规划、建筑设计、旅游规划等十余项。

<<苏州香山帮建筑营造技艺>>

书籍目录

目录
第一章 香山帮技艺的环境与源流
第一节 香山帮技艺的传播地域与传承环境
一、香山帮技艺传播的地域及影响
二、苏州的气候与自然环境
三、苏州的社会与人文环境
第二节 香山帮的文化渊源与香山帮的形成
一、吴文化与吴地建筑传统
二、香山帮的形成与发展
三、香山帮技艺的构成
四、香山帮的分工
第二章 香山帮建筑的布局与设计
第一节 建筑的布局与形制
一、住宅建筑的布局特点
二、园林的布局与建筑类型
第二节 建筑的设计
一、建筑艺术形象
二、建筑的尺寸与比例
三、屋面提栈
四、建筑的整体构造特点
第三章 香山帮传统建筑的营造技术
第一节 香山帮建筑木构架的特点及其营造工艺
一、香山帮大木构架的特点
二、梁架构件的制作与加工
三、香山帮屋架戗角制作工艺
四、轩的样式与构造
五、牌科的做法与制作安装
第二节 屋面水作工艺
一、屋面构造特点
二、屋脊样式
三、屋面基层工艺
四、屋面铺瓦工艺
第三节 台基、墙体与地面的营造工艺
一、基础与台明
二、墙体的砌筑
三、地面铺装工艺
第四节 建筑装折
一、外檐装折
二、内檐装折
三、装折制作与安装
第四章 香山帮传统建筑营造的装饰艺术与文化
第一节 油漆彩画艺术
一、香山帮油漆工艺的特点与分类
二、各类油漆做法说明
三、苏式彩画的艺术特点

四、彩画工艺及工序
第二节 雕刻艺术
一、香山帮雕刻的艺术风格与文化特征
二、香山帮砖雕工艺
三、香山帮木雕工艺
四、香山帮石雕工艺
第三节 香山帮建筑的营造过程与其中的民俗
第五章 香山帮匠师与技艺传承
第一节 香山帮匠师
一、香山帮的历史哲匠——蒯祥和姚承祖
二、香山帮技艺传承人
第二节 香山帮技艺的传承方式
一、拜师习俗与行规
二、匠谚口诀
第三节 香山帮技艺的传承与保护
一、香山帮技艺传承现状与问题
二、香山帮技艺原真性保护与技术发展的矛盾
三、香山帮技艺保护的整体性原则

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com